

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Works With	Quantidade por embalagem	Profundidade	Largura
--------------------	------	------------	--------------------------	--------------	---------

24830-005	Heat Conductor	Cases	1	22 mm	22 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE